

Dk 3.34 Df 0.0037
@13GHz

Tg(DSC) 185°C

T288(含铜)
>120分钟

应用

网络/无线通信

ICT 基础设施设备, 超级计算机, 测量仪器,
天线(基站、车载毫米波雷达)等

芯板

R-5775(N)* R-5775(K) R-5775(G)

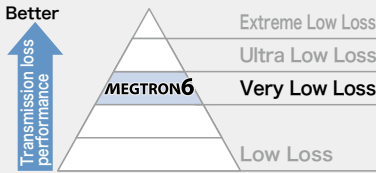
半固化片

R-5670(N)* R-5670(K) R-5670(G)

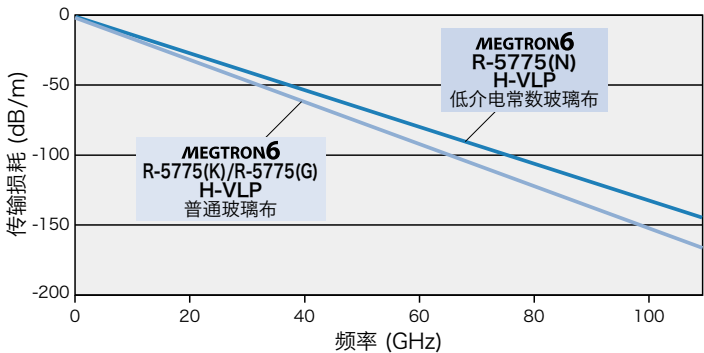
*低介电常数玻璃布类型

超低传输损耗・高耐热性多层基板材料

基于超低传送损失, 高耐热性,
高可靠性的高速材料行业通用产品。



传输损耗比较



高多层耐热性

结果

孔径	φ0.3mm	
通孔壁间距离	0.5mm	0.6mm
MEGTRON6 (低介电常数玻璃布)	合格	合格

条件

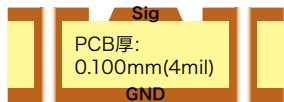
260°C回流焊×10次

叠构

32层
板厚: 4.5mm

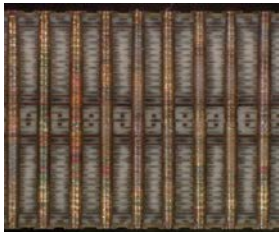
叠构

微带线



测定方法	2端口 S参数
测定频率	10MHz~110GHz
校正方法	TRL法
阻抗匹配	调整到 50Ω(Zo)

- 层1: 信号线层
(线宽: 270μm、铜箔厚度: 24μm)
- 层2: GND平面层
(铜箔厚度: 24μm)



一般特性

项目		试验方法	条件	单位	MEGTRON6 R-5775(N) 低介电常数玻璃布	MEGTRON6 R-5775(K)/R-5775(G) 普通玻璃布
玻璃态转化温(Tg)		DSC	A	°C	185	185
热膨胀系数(Z-轴方向)	α1	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	45	45
	α2				260	260
T288(含铜)		IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分钟	>120	>120
介电常数(Dk)	13GHz	平衡型圆盘共振法	C-24/23/50	—	3.34	3.62
介质损耗因数(Df)					0.0037	0.0046
铜箔剥离强	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.8 [H-VLP]	0.8 [H-VLP]

试验片厚度为0.75mm。

在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。

上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。

industrial.panasonic.com/ea/electronic-materials

松下电器机电 MEGTRON6

松下电器机电 (中国) 有限公司

© Panasonic Industry (China) Co., Ltd. 202503